

上海证券交易所

上证公函【2018】2667号

关于上海韦尔半导体股份有限公司重大资产 购买预案信息披露的问询函

上海韦尔半导体股份有限公司：

经审阅你公司提交的重大资产购买预案（以下简称预案），现有如下问题需要你公司作进一步说明和补充披露。

1. 预案披露，公司拟通过云南产权交易所参与竞买瑞滇投资持有的芯能投资 100%、芯力投资 100% 股权，其挂牌底价为 168,741 万元。上市公司的资金来源为自有资金及自筹资金，存在资金筹措风险。请补充披露：（1）本次交易自筹资金具体来源、现金对价的支付计划或安排；（2）截止目前，是否已经取得相关金融机构的授信；（3）自筹资金对公司财务费用及净利润的具体影响。请财务顾问发表意见。

2. 预案披露，2017 年 8 月 25 日，中信证券将芯能投资 100% 股权和芯力投资 100% 股权转让给瑞滇投资。请补充披露：（1）2017 年，瑞滇投资分别取得芯能投资 100% 股权和芯力投资 100% 股权的交易对价；（2）本次挂牌价与前述价格的差异及合理性。请财务顾问发表意见。

3. 预案披露，本次标的资产的挂牌价为 168,741 万元，2018 年

8月15日公司披露的交易预案中该部分对价为148,703万元。请补充披露：（1）本次交易对价相对于前次交易对价增加约2亿元的原因及合理性；（2）本次交易作价的变更对前次发行股份购买资产方案的影响。请财务顾问发表意见。

请你公司在2018年12月4日之前，针对上述问题书面回复我部，对重大资产重组预案作相应修改并披露。

上海证券交易
二〇一八年十一月二日

